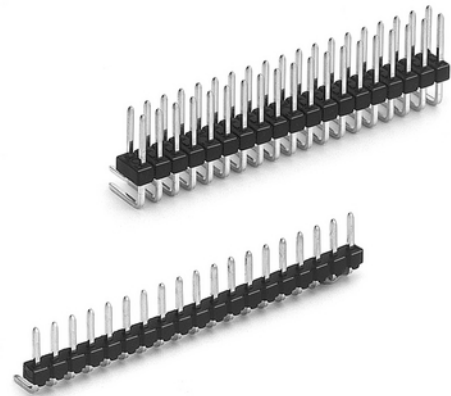


## Stiftleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig - 1,5mm Isolierkörper Pin Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row - 1.5mm Body

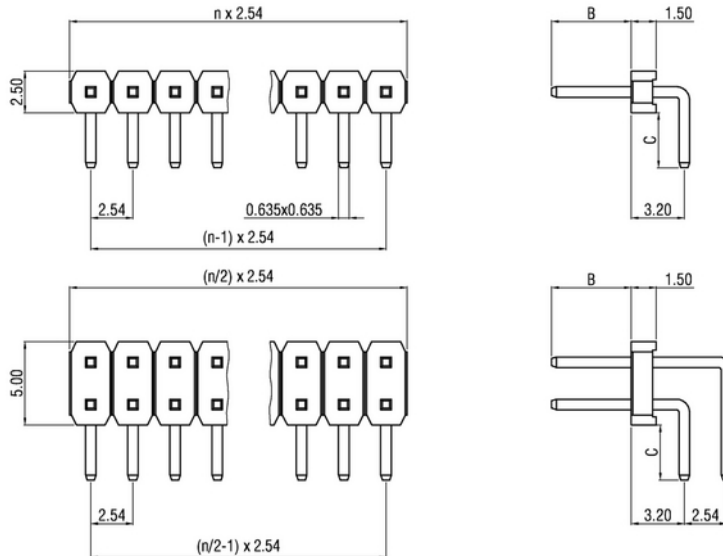
### Technische Daten / Technical Data

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Isolierkörper         | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0          |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                        |
| Kontaktmaterial       | Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung               |
| Contact Material      | Square pin 0.635mm, copper alloy                     |
| Kontaktoberfläche     | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)     |
| Contact Surface       | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm) |
| Lötbarkeit            | IEC 60512-12A                                        |
| Solderability         | IEC 60512-12A                                        |
| Durchgangswiderstand  | < 20mΩ                                               |
| Contact Resistance    | < 20mΩ                                               |
| Isolationswiderstand  | > 1000MΩ                                             |
| Insulation Resistance | > 1000MΩ                                             |
| Spannungsfestigkeit   | 1kV <sub>DC</sub>                                    |
| Test Voltage          | 1kV <sub>DC</sub>                                    |
| Nennspannung          | 250V <sub>AC</sub>                                   |
| Voltage Rating        | 250V <sub>AC</sub>                                   |
| Nennstrom             | 3A                                                   |
| Current Rating        | 3A                                                   |
| Temperaturbereich     | -40°C ... +105°C                                     |
| Temperature Range     | -40°C ... +105°C                                     |
| Verarbeitung          | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren                     |
| Processing            | Wave or reflow soldering                             |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten Serien:  
Mate with Female Header Series:  
**153 154 157 159 160/162 624** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more



### Series\*

**923**

**Gestanzte/geprägte Kontakte**  
Stamped/formed contacts  
**923** Einreihig  
Single row  
**924** Zweireihig  
Double row

### Dimensions\*

**12**

**12** B=3,50 C=3,30mm  
**13** B=4,80 C=3,30mm  
**14** B=6,10 C=3,30mm  
**15** B=6,90 C=3,30mm  
**16** B=9,90 C=3,30mm  
**17** B=12,00 C=3,30mm  
**18** B=13,80 C=3,30mm  
**19** B=15,00 C=3,30mm  
**20** B=17,10 C=3,30mm

### Contacts\*

**014**

**001-040** Einreihig  
Single row  
**004-080** Zweireihig  
Double row

### Plating\*

**00**

**00** Vergoldet  
Gold plated  
**50** Verzinkt  
Tin plated  
**60** Sel. Au/Sn  
Duplex plating

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm / 7,62mm / ... oder Sonderraster sowie weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.

We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm / 7.62mm / ... and other pitches as well as more pin lengths and dimensions on request.

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

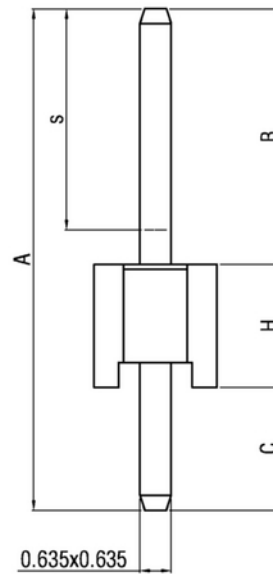
# Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

## Dimensions and PCB Layouts

### Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

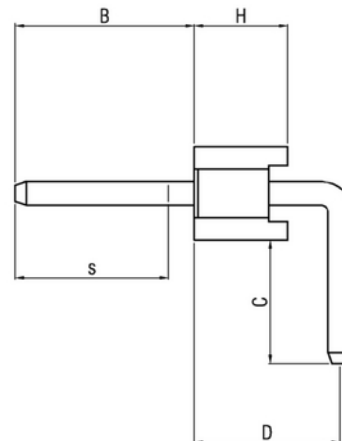
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



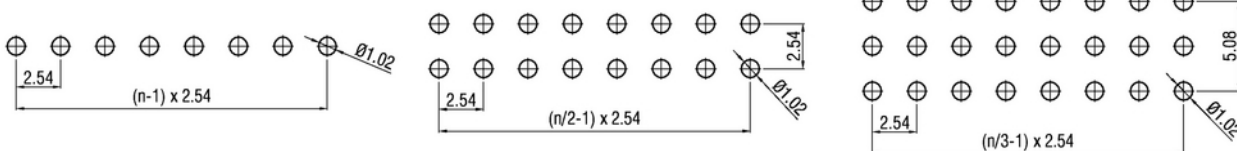
### Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



### PCB Layouts



## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert     |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150°C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60-180s      |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217°C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260°C ±5     |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$  | Max. 8 min   |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values   |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150°C        |
| Maximum Temperature $T_{Smax}$       | 200°C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60-180s      |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217°C        |
| Duration above $T_L$                 | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260°C ±5     |
| Duration Peak Temperature            | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | Max. 8min    |

